

概要

この通知は、一部のワイヤボンド BGA パッケージ向けモールド コンパウンドにおいて、新規セカンド ソースが追加されたことをお知らせするものです。この変更は、フィット、形状、機能、または信頼性に影響を及ぼしません。

変更内容

Nitto 社 GE100 シリーズのモールド コンパウンドは、ザイリンクスのプラスチック モールド型ワイヤボンド パッケージにおいて、セカンド ソースの材料として認定されました。この材料の追加によって、ザイリンクスは量産向け BGA (ボールグリッド アレイ) の継続的な供給が可能となります。

該当製品

表 1 に、この通知が適用されるパッケージを示します。これらのパッケージで提供されるザイリンクス デバイスはすべて、この通知の影響を受けます。これには、標準および鉛フリー パッケージの両方のデバイスと、関連するスピードおよびグレード (コマーシャル、インダストリアル、ミリタリ) が含まれます。

表 1: 該当デバイス

BG225	CS(G)280	FG(G)1156	FG(G)456
BG728	CS(G)48	FG(G)256	FG(G)484
BG(G)256	CS(G)484	FG(G)320	FG(G)676
BG(G)575	CP(G)132	FG(G)324	FG(G)900
CS(G)144	CP(G)56	FG(G)400	FT(G)256

トレーサビリティ

トレーサビリティはパッケージのトップ マークで確認できます。日付コードは、パッケージのトップ マークに表示されています (図 1 参照)。表 1 に示すデバイスは、2008 年 7 月 14 日 (日付コード 0829) 以降、新規のモールド コンパウンドで出荷される可能性があります。



XCN08006_01_041408

図 1: 日付コードを示すパッケージのトップマーク

キーデータおよび注文情報

新規の材料セットでの出荷は、2008 年 7 月 14 日以降に開始します。

メモ：2008 年 7 月 14 日以降のパッケージには、Sumitomo 社または Nitto 社のモールド コンパウンドが含まれる可能性があります。

品質データ

認定データは次の資料でご確認いただけます。

[RPT100 - Nitto 社の GE100 シリーズのモールド コンパウンド評価レポート](#)

お問合せ先

注意事項：JESD46-C に従い、この通知から 30 日以内にお客様から確認通知がなかった場合、この変更は許諾されたとみなされます。

この通知に対する回答は必要ありません。ご不明な点、ご質問等ございましたら[ザイリンクス テクニカル サポート](#)までお問い合わせ下さい。

重要なお知らせ：カスタマ変更通知 (PCN、PDN、Quality Alert) は、弊社のサポート ウェブ サイト <http://japan.xilinx.com/support> から e-mail によるアラート配信として受信できます。アラートにご登録後、My アラートにカスタマ変更通知が含まれるようにカスタマイズして下さい。これにより、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるようになります。登録方法は、[ザイリンクス アンサー #18683](#) を参照して下さい。

追加資料

この通知に関連する資料を次に示します。

- 評価レポート ([RPT100](#))

改訂履歴

次の表に、この通知の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2008/04/14	1.0	初版リリース
2008/04/17	1.0.1	トレーサビリティとキーデータおよび注文情報 に示す出荷日の変更

この通知は、英語版 (XCN08006、バージョン 1.0.1、2008 年 4 月 17 日発行) を翻訳したものです。